証券コード：6266

タツモ株式会社　決算説明資料

2021年12月期第3四半期

2021年11月12日

タツモ株式会社

© 2021 TAZMO Co., Ltd. All Right Reserved.

会社概要

TAZMO

社名	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	27億2,406万7,238円
従業員数	単体 360名/連結 1,096名（2021年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、液晶製造装置、 紫外線照射装置、めっき処理装置、精密金型・樹脂成型品 などの開発・製造・販売

沿革

1972	電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
1980	インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
	半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
1989	液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
1990	本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
	ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
1994	エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
1995	インジェクション成形品の製造・販売を開始
2001	半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
2004	JASDAQ市場に株式を上場
2008	TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

沿革

2009	第１０世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
	３Ｍ社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結
2013	アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
	ﾛﾝｱﾝ省ﾛﾝﾊｳ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
2015	第三者割当増資により、資本金16億1,683万円へ増資
2016	タツモ岡山技術センターを開設
2017	株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化
2018	東京証券取引所市場第一部へ市場変更
	新株式発行により、資本金27億2,406万円へ増資
2019	本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
2020	アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併

国内拠点・関連子会社

第1工場
第5工場
第3工場

ファシリティ出雲

東京営業所

クォークテクノロジー
プレテック

本社

ファシリティ本社

海外拠点

TAZMO

富莱得科技(東莞)有限公司

富莱得(香港)有限公司

TAZMO INC

TAZMO VIETNAM CO.,LTD

FACILITY HANOI CO.,LTD.

龍雲阿普理夏电子科技有限公司

上海龍雲精密機械有限公司

龍雲亞普恩科技股份有限公司

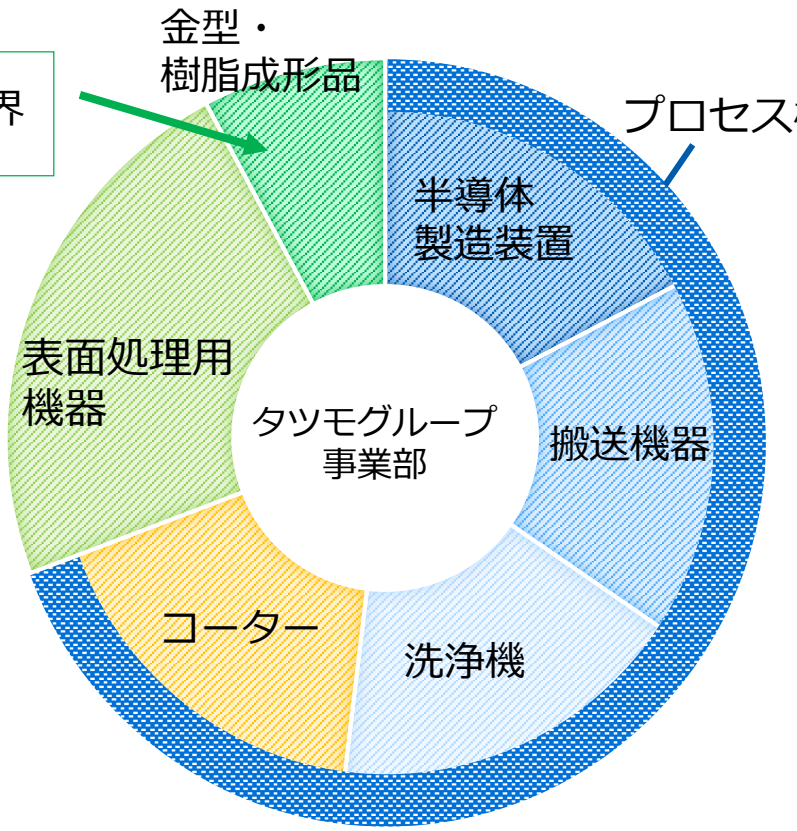
セグメント紹介

プレテック株式会社

金型・樹脂成形品業界

株式会社ファシリティ

PCB業界（※2）



タツモ株式会社

半導体製造装置業界
FPD製造装置業界（※1）

※1　フラットパネルディスプレイ
※2　電子回路基盤

半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、
めっき処理装置等の開発・製造・販売

事業紹介

TAZMO

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、
シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを
仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売

搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェーハ等搬送ロボットや
アライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した
製品等の開発・製造・販売

洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、
スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売

事業紹介

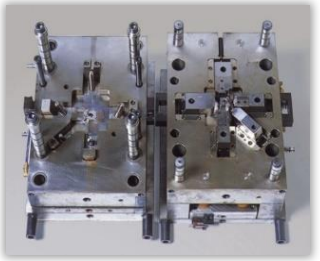
TAZMO

コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発･製造・販売

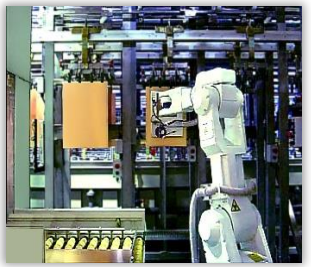
金型・樹脂成形品事業

電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使ったコネクター等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売



表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の開発・製造・販売



連結業績

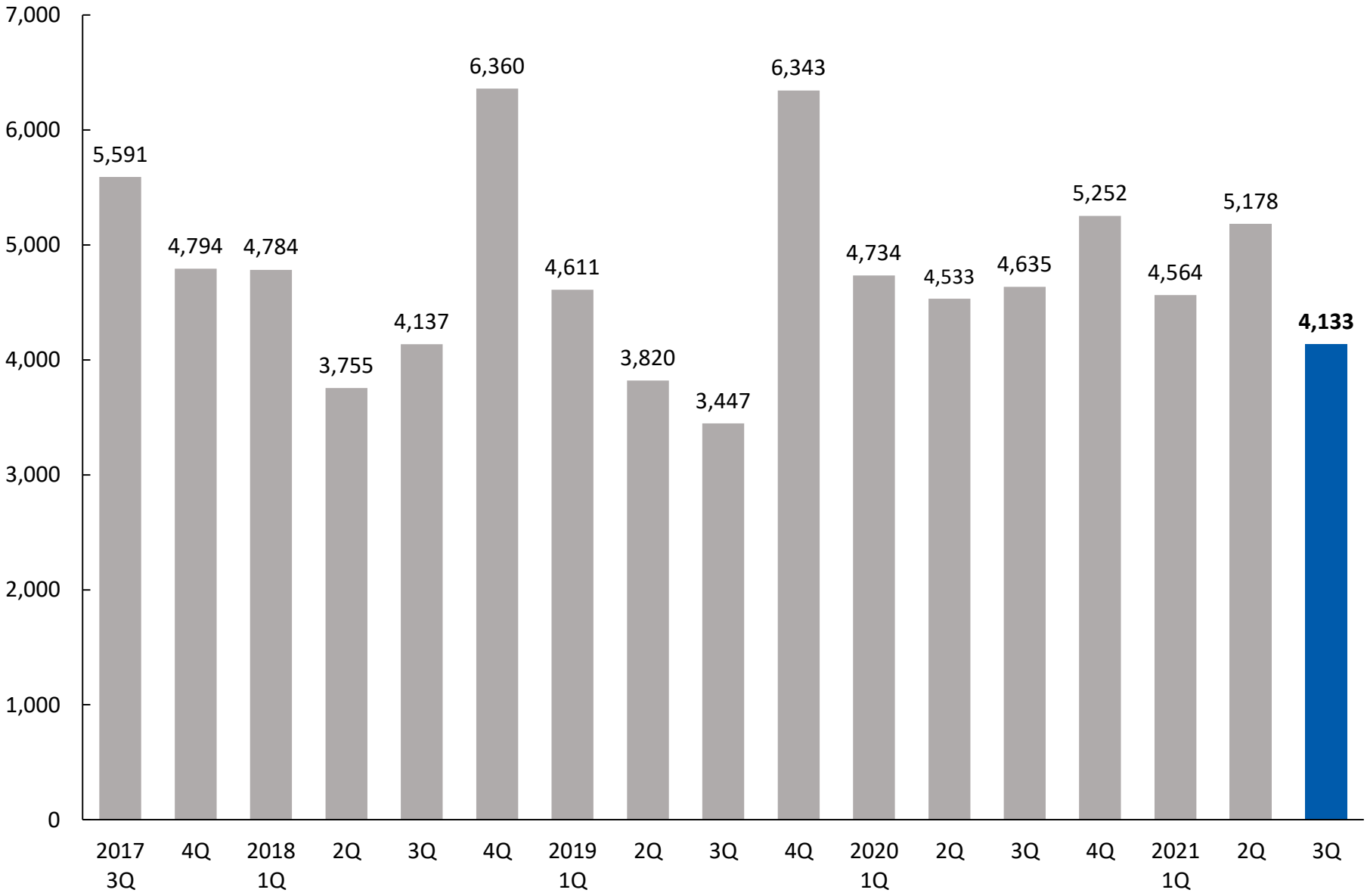
TAZMO

単位:百万円	’20年3Q	’21年3Q	売上比(%)	通期計画	進捗率(%)
売上高	14,264	13,876	–	22,749	61.0
売上総利益	4,126	3,575	25.8	–	–
販管費	2,482	2,736	19.7	–	–
営業利益	1,644	838	6.0	2,105	39.8
経常利益	1,620	927	6.7	2,160	42.9
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,199	620	4.5	1,553	40.0

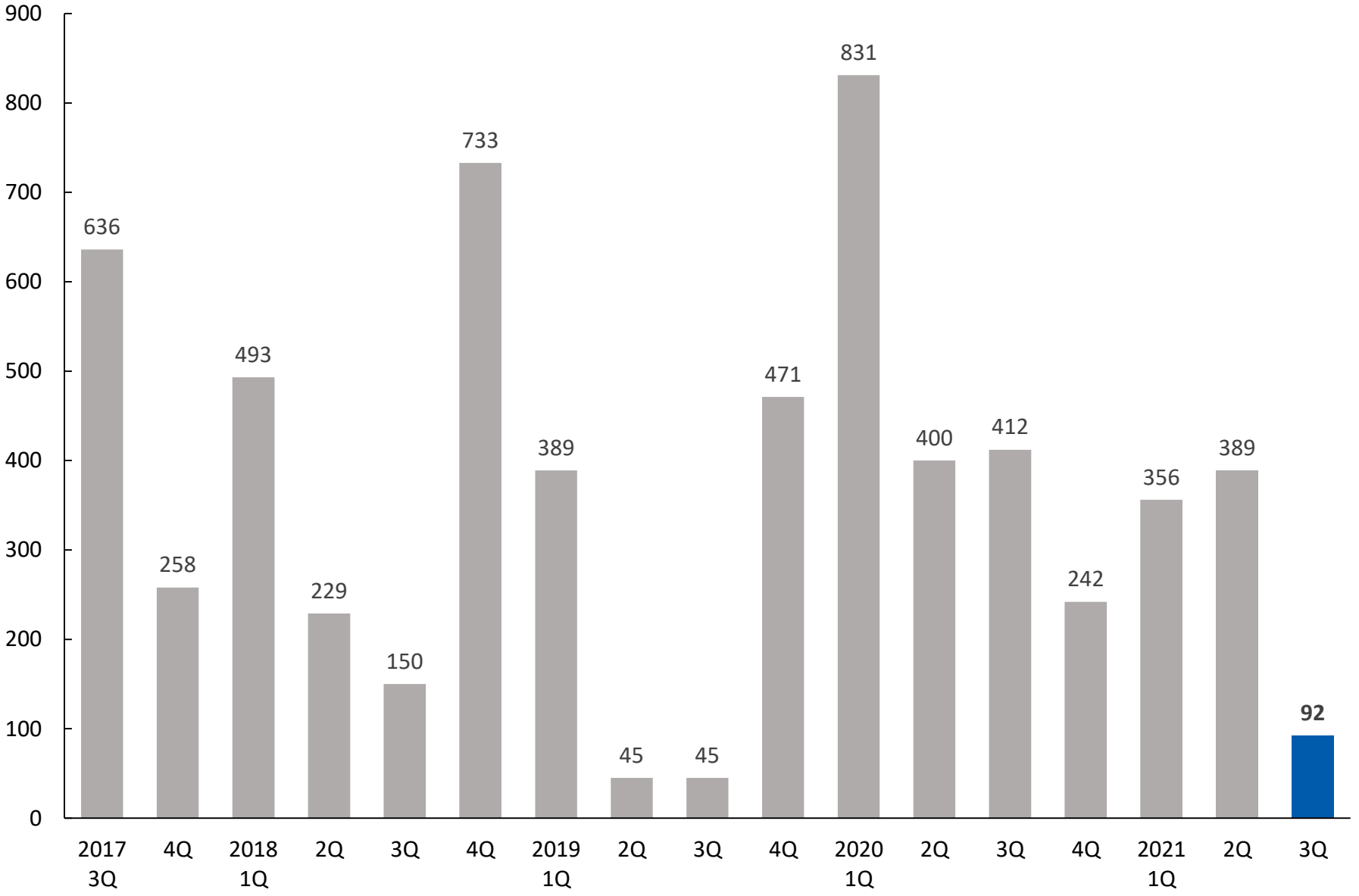
出荷装置の検収遅延等により売上は計画より若干下回る。

利益率の低い装置の売上計上　新規装置の開発費増加により利益率が悪化。

連結売上高推移


7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
5,591
4,794
4,784
3,755
4,137
6,360
4,611
3,820
3,447
6,343
4,734
4,533
4,635
5,252
4,564
5,178
4,133
2017 3Q
4Q
2018 1Q
2Q
3Q
4Q
2019 1Q
2Q
3Q
4Q
2020 1Q
2Q
3Q
4Q
2021 1Q
2Q
3Q

連結営業利益推移


900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
636
258
493
229
150
733
389
45
45
471
831
400
412
242
356
389
92
2017 3Q
4Q
2018 1Q
2Q
3Q
4Q
2019 1Q
2Q
3Q
4Q
2020 1Q
2Q
3Q
4Q
2021 1Q
2Q
3Q

連結貸借対照表

TAZMO

単位：百万円	‘20年12月期	‘21年3Q	増減
流動資産	19,650	20,784	1,134
有形固定資産	5,788	5,838	50
無形固定資産	171	151	△19
投資その他資産	1,160	1,375	214
総資産	26,771	28,150	1,379
流動負債	12,154	13,515	1,360
固定負債	3,042	2,329	△713
純資産	11,574	12,306	731
自己資本比率	42.6%	43.0%	0.4%

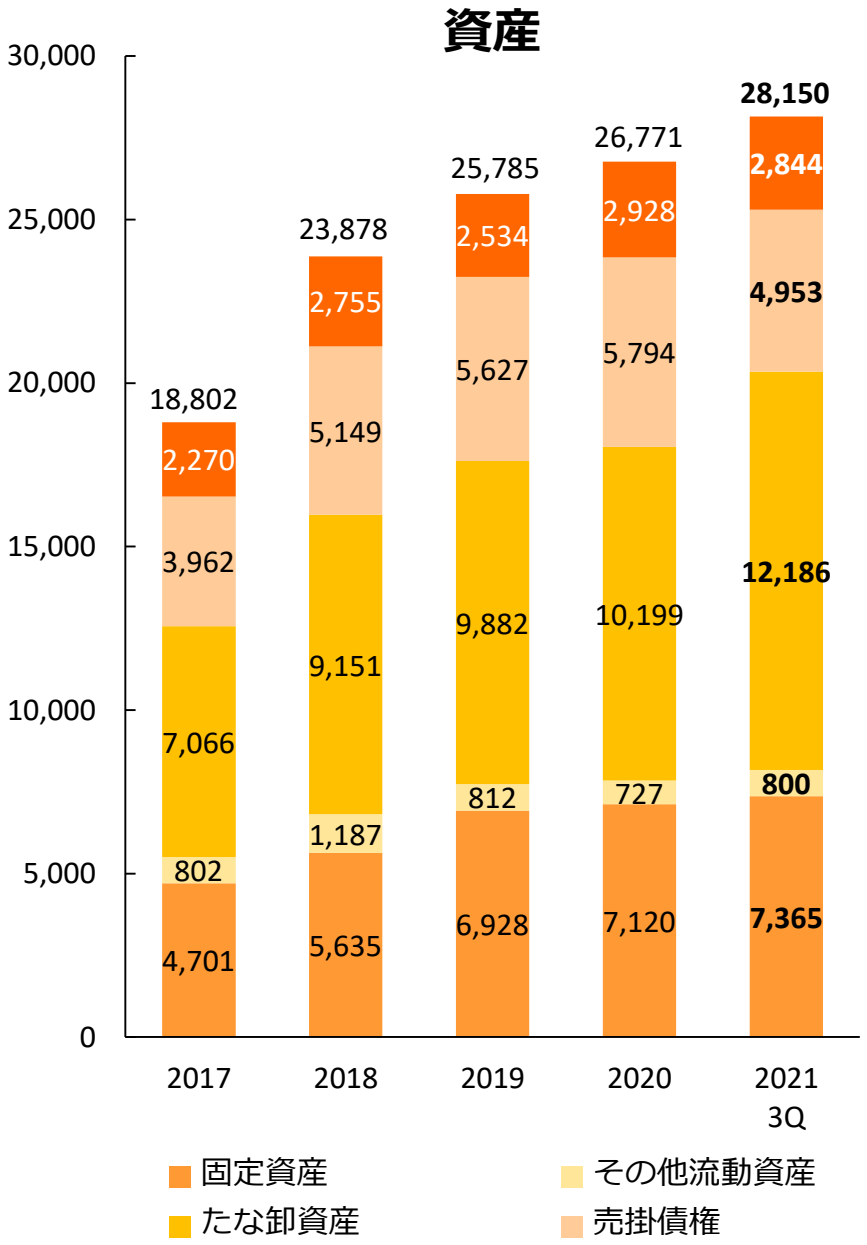
連結貸借対照表

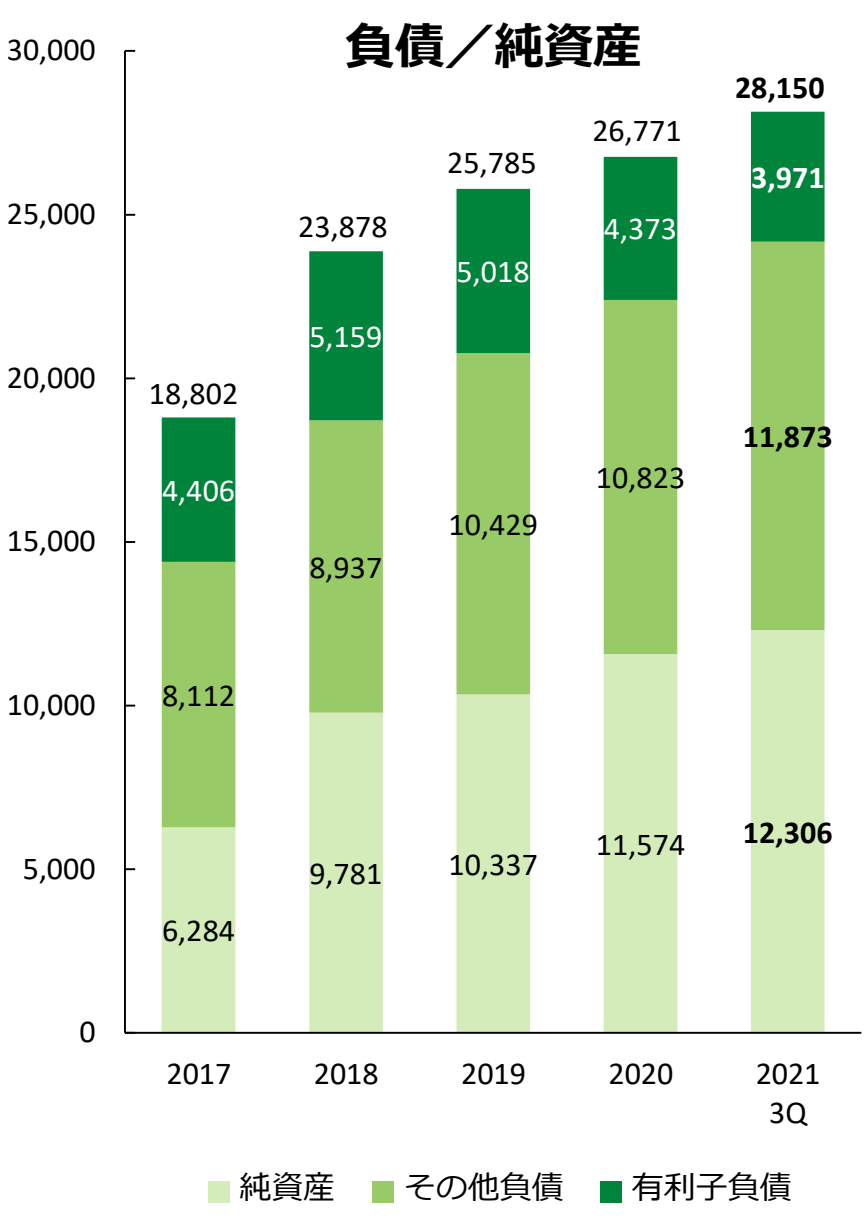
TAZMO

主な増減		単位：百万円
資産		
	‘21年3Q	前期末比
現金及び預金	2,844	△84
受取手形及び売掛金	3,583	169
電子記録債権	1,369	△1,010
たな卸資産	12,186	1,987
負債		
	‘21年3Q	前期末比
支払手形及び買掛金	1,806	350
1年内償還予定の社債	300	300
未払金	973	△210
前受金	5,462	752
長期借入金	1,644	△380

資産・負債／純資産推移

単位：百万円





セグメント情報

TAZMO

単位：百万円	’20年3Q	売上比（%）	’21年3Q	売上比（%）	今期計画	進捗率（%）
売上高	14,264	–	13,876	–	22,749	61.0
プロセス機器事業	11,081	77.7	10,909	78.6	16,912	64.5
半導体装置	3,079	21.6	2,453	17.7	4,884	50.2
搬送機器	3,651	25.6	3,961	28.5	5,289	74.9
洗浄機	1,979	13.9	2,052	14.8	2,564	80.0
コーター	2,371	16.6	2,442	17.6	4,173	58.5
金型・樹脂成形事業	1,045	7.3	1,155	8.3	1,523	75.8
表面処理用機器事業	2,136	15.0	1,811	13.1	4,313	42.0

半導体装置：4Qに売上予定案件が集中しており　前年同期比で20.3%減

搬送機器　：引き続き受注好調　ベトナム子会社も好調に推移　前年同期比8.5%増

洗浄機　　：検収が遅れ気味ではあるが、徐々に売り上げ計上　前年同期比3.6%増

コーター　：’20年未検収分の売上計上により　前年同期比3.0%増

セグメント情報

TAZMO

単位：百万円	’20年3Q	売上比（%）	’21年3Q	売上比（%）	今期計画	進捗率（%）
営業利益	1,644	11.5	838	6.0	2,105	39.8
プロセス機器事業	1,536	10.8	897	6.5	1,711	52.4
金型・樹脂成形事業	27	0.2	75	0.5	86	87.2
表面処理用機器事業	82	0.6	△122	△0.9	307	–
セグメント間連結消去	△1	–	△11	△0.1	–	–

プロセス機器事業　：半導体装置の売上減少　新規装置の開発費増加により　前年同期比41.6%減

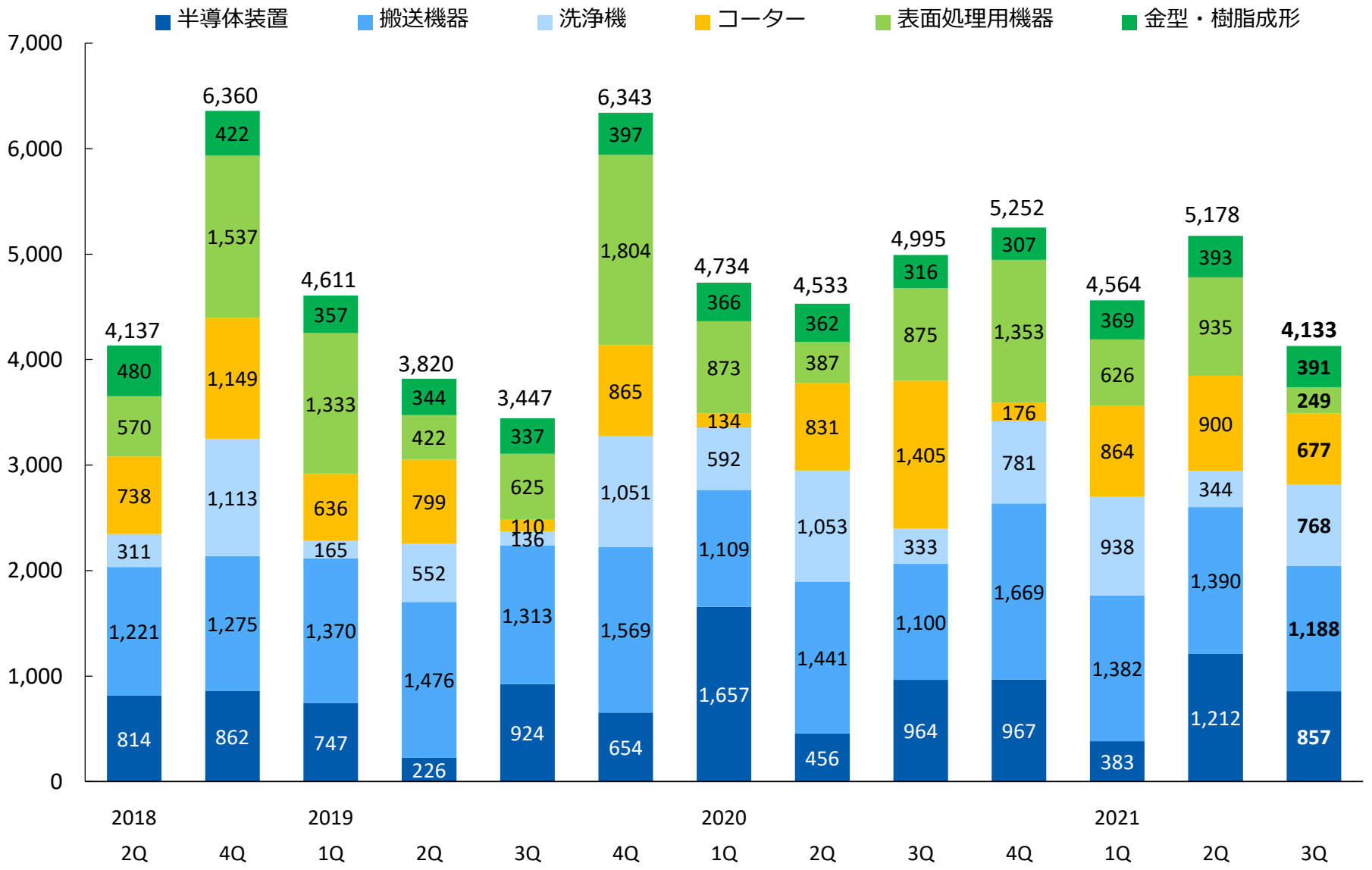
金型・樹脂成形事業：コネクター成形が好調　上海子会社のコネクター組立回復　前年同期比177.5%増

表面処理用機器事業：プリント基板メーカーの設備投資は回復傾向にあるが　利益率の低い案件が多かったため赤字となる

セグメント別　売上高推移

TAZMO

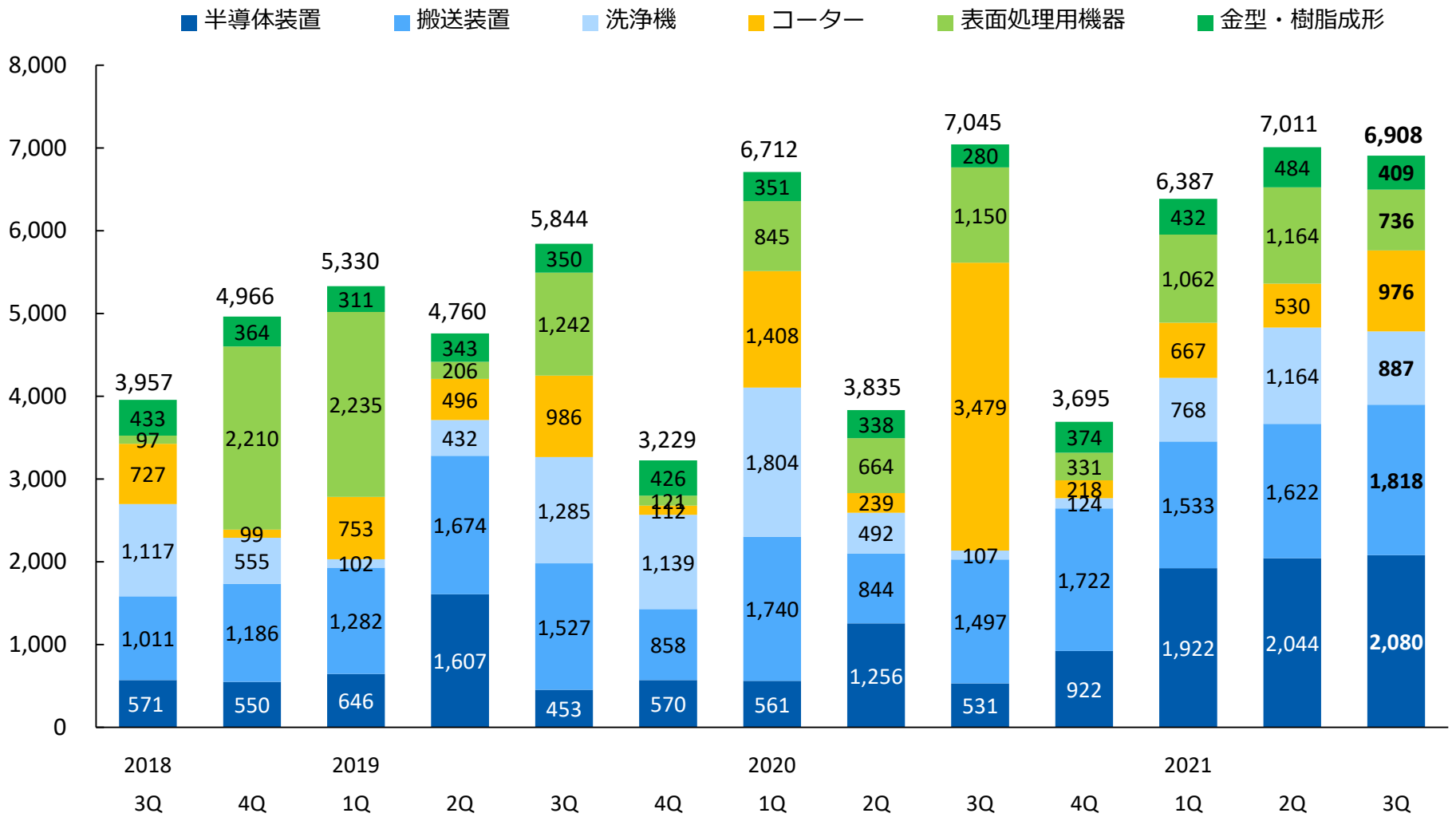
単位：百万円



セグメント別　受注高推移

TAZMO

単位：百万円



プロセス機器事業　：半導体装置・搬送機器の受注は引き続き好調。洗浄機も大口案件あり。

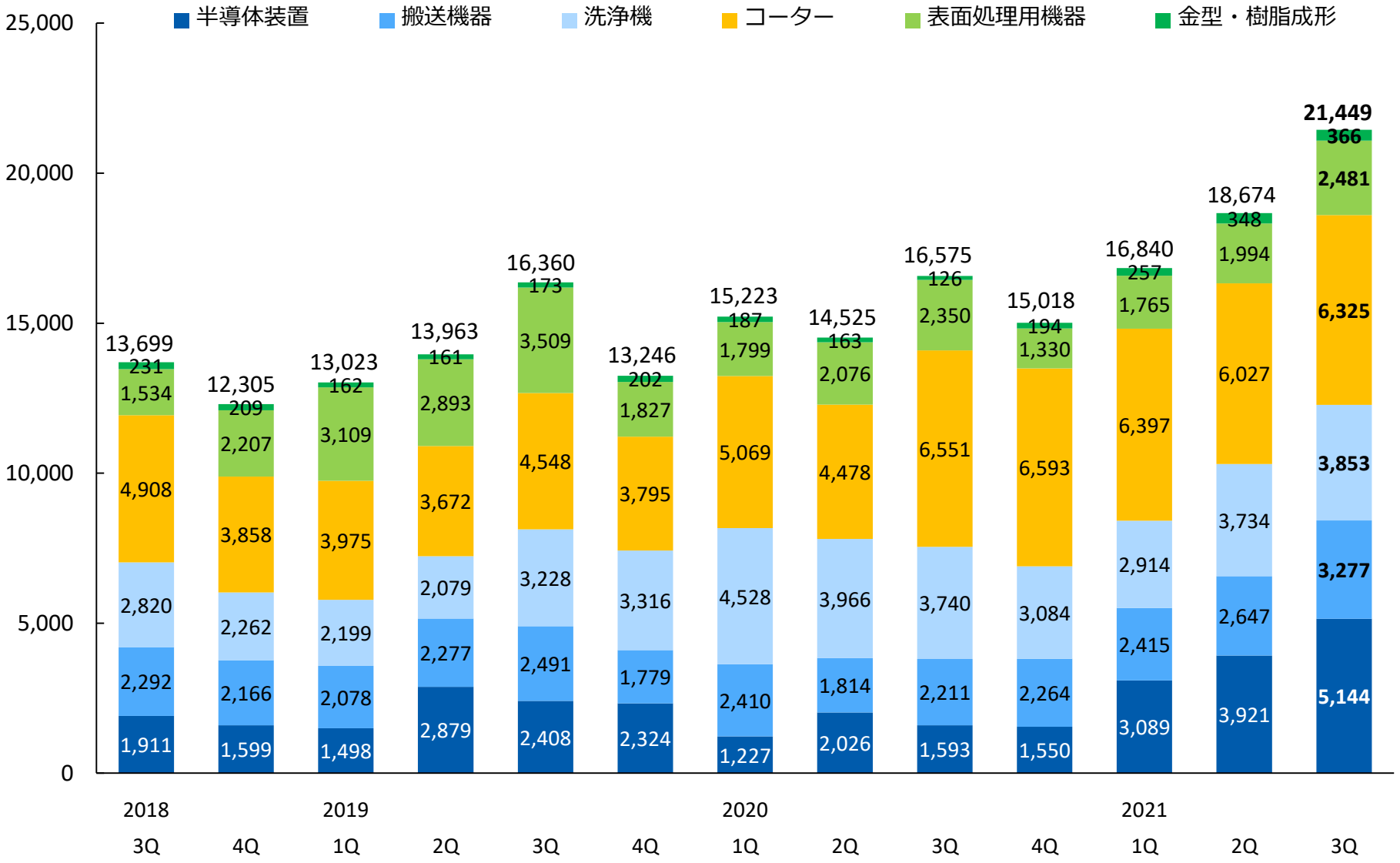
表面処理用機器事業：引き続き引合・受注が好調。

金型・樹脂成形事業：コネクター関係の受注好調。

セグメント別　受注残高推移

TAZMO

単位：百万円



- 半導体装置はパワー半導体向け貼合/剥離装置の引合増加。受注に向け生産工程管理・生産体制を強化し対応。
- 搬送機器は引続き受注好調であるが、部品調達が逼迫し納期が長期化している。
- 洗浄機で今後3年間にかけて大口引合あり。全台数受注に向け生産計画・工程管理を見直し対応。
- ナノインプリント量産用デモ機の出荷・立上完了。顧客に対してデモ実施中。
- 金型・樹脂成形でコネクターの需要は引続き好調であるが、樹脂材料の調達が困難であり生産計画が立てにくい。
- 表面処理用機器は国内車載用プリント基板メーカーの設備投資が堅調。来季に向け確実な受注を目指す。
- 部品・材料の入手が難しくなっており、早期発注等により対応している。
- 材料費の高騰については現状大きな影響はないが、今後の受注・利益に影響の懸念あり。

注意事項

本資料の取扱上の注意

本資料は、2021年11月12日発表の決算短信に基づいて作成されております。

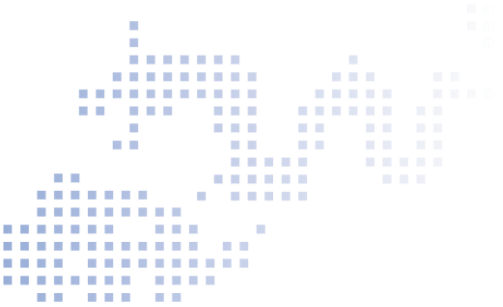
また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

掲載内容には最新の注意を払っておりますが、掲載されて無いように基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社　経営企画室

TEL　086-239-5000
FAX　086-239-5100
Email　keiki@tazmo.co.jp



© 2021 TAZMO Co., Ltd. All Right Reserved.